

テクニカルインフォメーション

6107 銀導体

チップ、ネットワーク電極用

銀導体ペースト#6160 は、チップ、ネットワーク抵抗の端子用に開発されました。です。非常に小さい部品の印刷に適するように作られています。 #6107 はカドミウム、鉛、ニッケルや有害な有機物を含んでいません。

主な特徴は

- RoHS 適合
- 高導電性
- 高線解像度
- 高速プリント
- 抵抗、絶縁体に適合可

主な焼成特性⁽¹⁾

焼成厚 8-12 ミクロン

線解像度 175/125 ミクロン ライン/スペース 150/150 パターン、325 メッシュ使用時

抵抗率 2.5Ω/□以下 12μm 厚

半田付け性 良好(Alpha 611 フラックスを用い、225 +5 の半田槽に 5 秒つけたとき、導体パターン、パッドがほぼ 100%半田でおおわれる。)

耐半田食われ性⁽²⁾ 5 サイクル

接着性⁽³⁾ 初期値 22N 以上

500 時間 @150 16N 以上

(1) 上記数値は複数のバッチサンプルを様々な条件下で測定したもので、スペックの上限下限を意味していません。

(2) 1 サイクルは Alpha 611 フラックスを用い、225 +5 の半田槽に 10 秒つける。

(3) 接着性の試験は 20AWG 鈴メッキ銅線をもちい、0.08" X 0.08"角のパッド上に 225 +5 の半田槽に 5 秒つけるその後 90 度まげて一定速度で引き、はがれるときの力を測定する。

成分特性

粘度 135+-15Kcp, Brookfield HBT、スピンドル#14, 10rpm@25 度

溶剤 Koartan A-1039

推奨プロセス

印刷

250um メッシュ(SUS), 乳剤 10-15 ミクロン、スキージ 45 度を推奨します。その他特殊な用途では、200-325um メッシュ、乳剤 5-25 ミクロンで適当に調整を行ってください。スキージ速度は 10 インチ/秒まで使われます。

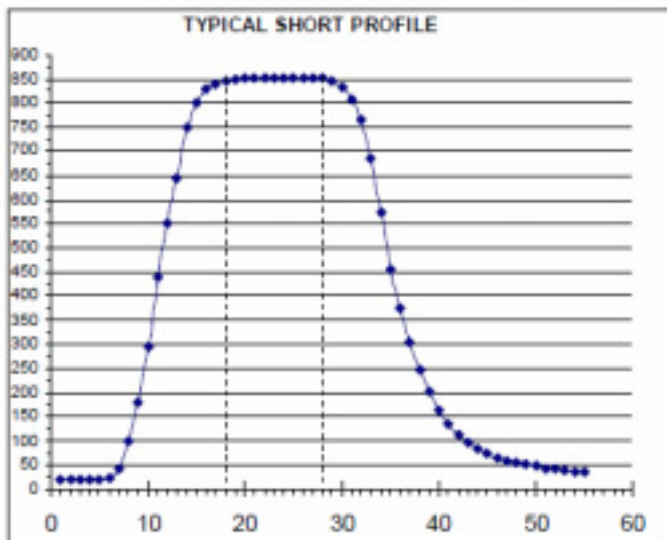
325 ミクロン メッシュ, 印刷厚 35 ミクロンのとき、適用範囲は 80cm² です。

乾燥

乾燥前に 5-10 分放置してレベリングさせてください。対流式オープンやベルト乾燥炉を使用して、125-150 で 10-15 分保持して乾燥させます。

焼成

エアベルト焼成炉で、ピーク温度 850 度にて 10 分保持、トータルで 36-60 分のプロファイルを推奨します。焼成炉内のエアの流量は、脱バインダーが適切に行われ、マッフル内が完全に酸化雰囲気になるように調整してください。



保管

蓋を密閉した状態で室温にて保管してください。未開封の場合、6 ヶ月間保存可能です。使用前には十分かき混ぜてください。通常希釈は不要ですが、印刷条件によっては、溶剤の揮発が発生することがあります。その際には、Koatan A-1039 で希釈してください。(最大でペースト重量の 0.5%の溶剤を添加します。)